



平成 24 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名:東京エレクトロン株式会社
代表者名:代表取締役社長 竹中 博司
(コード番号: 8035 東証第 1 部)
問合せ先:総務部長 前島 裕紀
(T E L 03-5561-7000)

米国ネックス・システムズ社買収についてのお知らせ

東京エレクトロン株式会社(本社:東京都港区、社長:竹中 博司)は、ウェーハレベル・パッケージング装置の開発・製造を行うネックス・システムズ社(NEXX Systems Inc. 以下 NEXX 社、本社:米国マサチューセッツ州、President and CEO:Tom Walsh)の買収に関して合意に達しましたことをお知らせいたします。

スマートフォン、タブレットなど多機能モバイル端末の急速な普及に伴い、より薄く、小型で、消費電力の低い高性能デバイスを実現するための先端パッケージ技術に対するニーズが高まり、その市場も大きく成長すると期待されています。

東京エレクトロンは、既に市場から高い評価を得ている NEXX 社の先進的パッケージングアプリケーションを獲得することで事業参入領域を拡大し、当社の持つ幅広い製品群とワールドワイドのサポート体制を融合させて、お客様のニーズに迅速に対応してまいります。

NEXX 社について

事業内容:ウェーハレベル・パッケージング向けめっき装置およびスパッタ装置の開発・製造

従業員数:139 名(2011 年 12 月 31 日時点)

売上高:76.5 百万ドル(2011 年 12 月期)

NEXX 社は、フリップチップパッケージおよびその他の先端パッケージング分野において、銅ピラーバンプや再配線層などに使われる成膜装置を、優れた技術ソリューションと高い生産性を持ってお客様に提供している企業です。2001 年の創業以来、NEXX 社は 40 社以上の半導体メーカーおよびパッケージ・アセンブリ受託企業に向けて延べ 142 台の装置を販売しており、最先端のウェーハレベル・パッケージ製造分野で業界をリードしています。

NEXX 社ウェブサイト:www.nexxsystems.com